

関係各位

レンゴー株式会社
広報部

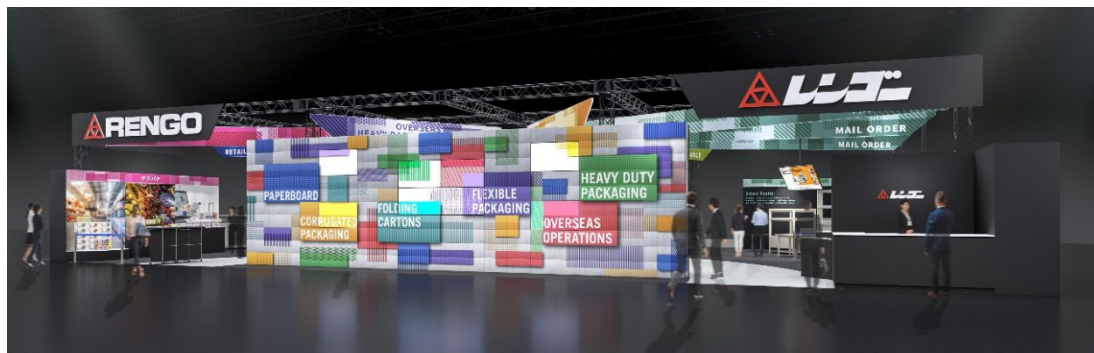
TOKYO PACK 2022 –2022 東京国際包装展– に出展します

レンゴー株式会社は、TOKYO PACK 2022 –2022 東京国際包装展– に出展いたします。

当社ブースでは「暮らしを支え、未来をつくる サステナブル パッケージング」をテーマに、6つのコアビジネスのSDGsへの取組みについて紹介します。

通販ソリューションでは、非接触対応として注目される「ポストインケース」の製函機と封函機を展示するほか、前回から好評の抗ウイルスや、プラスチック代替などの環境対応製品、サプライチェーン全体の環境負荷低減に寄与するパッケージ「RSDP（レンゴー スマート・ディスプレイ・パッケージング）シリーズ」、海外でも展開を図る重包装など、当社が持続可能な社会のために開発する製品と技術をご覧ください。

少ない資源で大きな価値を生む「Less is more.」をコンセプトに、包装の新たな価値を創造し続ける「ゼネラル・パッケージング・インダストリー」=GPIレンゴーの最新の姿をぜひともご高覧賜りますようご案内申し上げます。



<TOKYO PACK 2022 開催概要>

会期 2022年10月12日（水）～14日（金） 10:00～17:00

会場 東京ビッグサイト（東京国際展示場） 東1～3・6ホール

テーマ 新時代パッケージここに集う！—未来のために機能進化と使命—

主催 公益社団法人日本包装技術協会（JPI）

入場 無料（入場にはご登録が必要です）

新型コロナウイルス感染症対策に努めて会場運営いたしますが、ご来場の皆さまにもご理解とご協力をお願い申し上げます。

(1 / 2)

<当社関連の出展／展示ブース>

- ・レンゴースブース 東1ホール 25番(E1-25)
- ・クリーン・オーシャン・マテリアル・アライアンス事務局（CLOMAパビリオン）に出展 東6ホール 63番(E6-63)
- ・2022 グッドパッケージング展では日本パッケージングコンテスト入賞作品10点展示 東6ホール 78番(E6-78)

以上